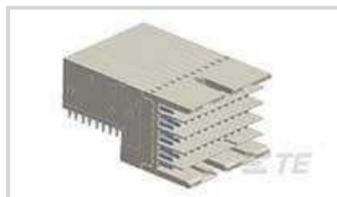




Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **192**

Reihenabstand: **1.25 mm [ .05 in ]**

Gegensteckführung: **Mit**

Typ der Gegensteckführung: **Polarisierung**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Backplane-Modultyp	Mitte
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Ohne Umhüllung
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Paare pro Spalte	8
Anzahl der Paare	96
Stapelbar	Ja
Anzahl der Signalpositionen	192
Anzahl von Positionen	192
Zeilenanzahl	8
Spaltenanzahl	12
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel

### Elektrische Kennwerte

Impedanz	30 Ω
Arbeitsspannung	30 VAC

### Signalmerkmale

Datenrate	3.5 Gb/s
-----------	----------

### Sonstige Eigenschaften

Abschirmungsmaterial	Kupferlegierung
----------------------	-----------------

### Kontaktmerkmale

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	.5 – 2.5 $\mu\text{m}$ [20 – 100 $\mu\text{in}$ ]
Kontakttyp	Stift
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontakt-nennstrom (max.)	.5 A

### Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	1.6 mm[.493 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit

### Montage und Anschlusstechnik

Führungskomponenten	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

### Gehäusemerkmale

Anzahl der gehüllten Seiten	0
Endwandposition	Keine
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
Gehäusefarbe	Naturbelassen
Raster	1.45 mm[.057 in]

### Abmessungen

Steckverbinderlänge	17.3 mm[.681 in]
Stapelhöhe	1.6 mm
Steckverbinderhöhe	9.5 mm[.374 in]
Steckverbinderbreite	12.51 mm[.493 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.2 mm
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	.4 mm[.016 in]
Reihenabstand	1.25 mm[.05 in]

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Haltbarkeitsklassifizierung	250 Cycles
Stromkreis Anwendung	Signal

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tray
--------------------	------

## Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Cadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



## Auch serienmäßig | Z-PACK Slim UHD



## Kunden kauften auch diese Produkte





## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### RA Male Connector, IEC L3

Englisch

### CAD-Dateien

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2042139-2\\_1.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2042139-2\\_1.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2042139-2\\_1.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Produktspezifikationen

#### Anwendungsspezifikation

Englisch

### Freigabe Agentur

#### UL-Bericht

Englisch